

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2018-028

# 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2018 年 3 月 26 日公司总股本 472,262,993 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	扬杰科技	股票代码	300373
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁瑶	秦楠	
办公地址	江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号	江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号	
传真	0514-87943666	0514-87943666	
电话	0514-87755155	0514-87755155	
电子信箱	zjb@21yangjie.com	zjb@21yangjie.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司主要业务情况

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端

领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN 产品、SGT MOS及碳化硅SBD、碳化硅JBS等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。

目前，公司设有广州、深圳、厦门、宁波、温州、杭州、上海、武汉、成都、青岛、天津等12个国内技术服务站，境外设有台湾、韩国、美国、德国、土耳其、意大利、法国、墨西哥等8个国际营销网点。通过实行“扬杰”和“MCC”双品牌运作，不断扩大国内外销售网络的辐射范围，为各大终端客户提供直接的专业产品和技术支持服务，持续提升公司国际化服务水平。

## 2、公司所处行业分析

半导体功率器件作为基础性的功能元器件，应用涵盖了消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等配套领域。随着半导体功率器件行业新型技术特征的发展，其应用领域将不断扩大。由于半导体功率器件所服务的行业领域较广，具体受下游单一行业周期性变化影响并不显著，但与整体宏观经济景气度具有一定的关联性。

半导体功率器件行业市场化程度较高，行业集中度低，具备芯片研发、设计、制造全方位综合竞争实力的国内本土公司只有少数。

公司凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，公司产品已在诸多新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况，公司连续数年被中国半导体行业协会评选为“中国半导体功率器件十强企业”。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,469,508,389.85	1,190,162,835.24	23.47%	833,893,445.20
归属于上市公司股东的净利润	266,556,925.90	201,820,895.86	32.08%	137,802,662.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,423,865.13	190,600,679.64	13.02%	125,074,776.05
经营活动产生的现金流量净额	245,392,027.64	253,501,313.32	-3.20%	84,431,067.38
基本每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.33
加权平均净资产收益率	12.50%	15.99%	-3.49%	17.68%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	3,289,133,321.74	2,488,832,714.88	32.16%	1,330,512,470.53
归属于上市公司股东的净资产	2,268,652,847.14	2,021,109,057.94	12.25%	844,660,394.43

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,878,916.67	384,981,224.13	409,047,140.48	373,601,108.57
归属于上市公司股东的净利润	54,621,696.62	80,719,067.27	69,063,957.36	62,152,204.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,292,186.55	65,859,928.46	55,591,950.02	52,679,800.10
经营活动产生的现金流量净额	14,236,326.69	27,072,640.96	130,182,928.79	73,900,131.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏扬杰投资有限公司	境内非国有法人	41.59%	196,500,000	176,500,000	质押	18,020,000	
扬州杰杰投资有限公司	境内非国有法人	16.40%	77,500,000	57,500,000	质押	22,450,000	
王艳	境内自然人	2.33%	11,000,000	0			
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	7,330,578	0			
全国社保基金五零四组合	其他	0.98%	4,639,434	0			
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	4,510,000				
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,048,378	0			
招商财富—招商银行—招商财富—瑞丰向阳 4 号专项资产管理计划	其他	0.85%	4,037,372	0			
招商财富—招商银行—招商财富—瑞丰向阳 3 号专项资产管理计划	其他	0.85%	4,033,293	0			

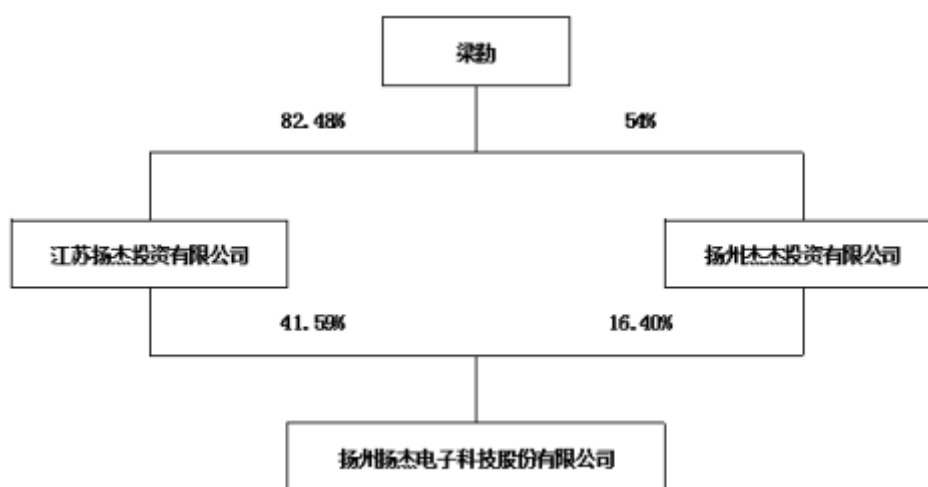
全国社保基金 六零二组合	其他	0.81%	3,826,241	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、江苏扬杰投资有限公司和扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

#### (1) 研发技术方面

A、报告期内，公司紧跟市场需求，持续扩大微型贴片封装的研发投入，采用全新的高密度产品结构，其中高密度料片的贴片系列产品研发成功并实现大规模量产，为国内首家，可有效降低制造成本10%以上；同时，公司投资新建小信号生产线，成功开发SOD&SOT系列产品，多款新品一次性实现量产，进一步扩大公司主营产品版图，以满足客户多元化需求。

B、公司成立晶圆研发部，整合多方研发力量，成功研制放电管芯片及高压模块雪崩圆形芯片，进一

步改善提升TVS产品性能，充分发挥晶圆-封装-销售的协同效应，提高公司产品在智能交换机、通讯设备、轨道交通等下游领域的竞争力；公司实现6英寸肖特基芯片的全系列开发，大范围覆盖各种电流电压规格，提升了公司在消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等下游应用领域的市场竞争力。

C、公司组建MOSFET、FRED和IGBT器件研发及市场团队，专业从事于高端半导体功率器件的技术研究、产品设计和市场开发，实现了数款中低压沟槽功率MOSFET产品的量产，产品性能和良率均达到国内同行最优水平；同时，完成了FRED和IGBT产品的技术积累和产品布局。公司成功掌握现阶段中低压MOSFET最新主流技术SGT MOS，将为公司开拓同步整流电路及高频电路等高端市场奠定坚实基础。

D、公司持续推进第三代宽禁带半导体项目的研发及产业化，加强碳化硅领域的专利布局，加大碳化硅芯片量产工艺相关自主知识产权的储备；针对650V/1200V碳化硅JBS产品，持续优化自主版图设计，导入新工艺制程，提升产品性能；开发并改进可与硅线相互兼容的生产工艺，以增强产能结构实时调整的能动性；同时，保持与车载充电机、电动汽车充电桩、光伏逆变等领域客户的密切联系，高度关注客户需求，对碳化硅产品进一步优化与升级。

## （2）市场营销方面

A、报告期内，公司持续推进国际化战略布局，继续加强德国办事处的建设，设立意大利办事处、法国办事处，完成EMEA（欧洲、中东、非洲）地区的销售网络搭建，实现海外市场与国内市场的双向联动，确保产品认证与批量合作的无缝对接；加强“扬杰”和“MCC”双品牌推广，进一步发挥品牌影响力，推动与大型跨国集团公司的合作进程。

B、公司以消费类电子、安防、新能源行业为市场发展基础，大力拓展工业变频、网通等工业电子领域，重点布局充电站（桩）、光伏微型逆变器、汽车电子等高端市场，挖掘公司新的利润增长点。

C、公司坚持以精准化营销、全方位服务的原则进行市场推广，设立行业开发经理及大客户开发经理，聚焦各行业内的标杆客户；同时，加大对专业技术型销售人才的培养力度，推动技术型销售人员与客户的同步互动，为客户提供有力的技术支持服务。

D、多款功率MOSFET产品的成功开发量产，与公司现有客户产品形成配套，有利于加大公司与客户合作的深度与广度，预计未来将为公司贡献持续稳定的销售收入；公司持续推广太阳能光伏模块，已实现规模销售，并成功进入光伏领域全球出货量TOP10厂商的供应商体系。

## （3）运营管理方面

A、报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生产效率、提升产品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有效激发员工的改善意识与参与热情，报告期内共收集革新提案231件，实现改善收益过千万元。

B、公司加大对战略性高毛利产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边际效益；持续提升生产线自动化程度，微型贴片封装产品自动线全程实行CCD（图像控制器）监控，保证产品一致性，为客户提供更优质的产品。

C、4寸晶圆线积极推进资源整合，实施扩产项目，成本优势不断增强，产品交货周期进一步缩短，可全方位满足客户需求；新投产的6寸晶圆线产能逐步释放，投入产出比、存货周转天数等各项指标均处于

业内一流水平，进一步保证了公司在芯片供应趋紧时的生产弹性。

D、SAP（企业管理解决方案）系统实现全面上线，成为公司及各子公司的统一ERP管理平台，为公司信息化管理、物流后勤、财务管控提供强大的软件支持；完成SAP系统与MES、CRM、SCM、OA及银行、税务系统的集成，提高系统作业流程的整体效益；进一步规划核心网络体系，完成虚拟化服务器应用平台的搭建，为公司的信息技术运行提供更高效、可靠、稳定的基础架构。

#### （4）人力资源方面

A、报告期内，公司全面导入并正式运行HRBP（人力资源业务伙伴）体系，完成HRBP团队的建立，发挥人力资源SSC（共享服务中心）职能，初步实现人力资源在业务端的价值最大化，充分保障公司战略在业务端的更好落地以及人才培养工作的细致开展。

B、公司加强中枢职能部门建设，持续优化组织架构。进一步丰富提升市场部职能，全面开展产品规划与市场调研工作，为公司战略的规划与落地指引方向；同时，完成晶圆运营中心人员与架构的全面整合，为今年年底达成扩产目标提供有力的组织保障。

C、公司积极开展人才梯队建设，完成年度人才盘点、管理干部述职考评、轮岗等工作，新提拔经理人8名，降职或转岗经理人6名，实现人均销售额同比提高10%；强化后备人才队伍建设，持续开展面向应届大学毕业生的“潜龙计划”，启动“青松计划”人才培养项目，引进100名大专、技师类毕业生，为设备、基层管理干部提供强有力的人才保障。

D、公司重视并强化中高层管理人员的能力提升，先后安排数十人参加领教工坊高管组织能力提升培训、日本厂部长训等外出学习活动，有效提升了中高管的人力资源管理能力及经营管理能力，有利于公司内部实施企业文化更新挑战、一年三件事及工厂独立核算与考核等工作。

E、公司与扬州高等职业技术学校合作现代学徒制试点项目，创办“扬杰电子科技学院”，开启了内部技术人才培养的新模式，学校的软硬件建设及首批招生工作顺利完成，通过校企双方的共同努力，将为地方、学校和公司培养更多更好的优秀人才。

#### （5）外延发展方面

A、报告期内，公司入伙北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙），成为合伙企业的有限合伙人。通过与在半导体领域有着专业投资经验和丰富项目资源的专业机构合作，公司承担有限风险，分享产业投资及并购市场的回报，获取投资收益；同时，借助合伙企业优秀的投资管理团队和资源优势，进一步拓展了公司的项目投资渠道，有利于发掘并培育符合公司发展战略和产业链布局的新项目，为公司的产业整合积累项目 and 经验。

B、公司收购成都青洋电子材料有限公司60%股权，成为其控股股东，实现上游关键原材料的内部配套，保证了功率半导体芯片及器件产品的优良品质；同时，有利于发挥协同效应，助力公司稳步打通上游半导体材料领域，逐步形成半导体材料供应、芯片设计制造、分立器件封装测试互动发展的新型产业链格局，为公司未来实现跨越式发展奠定良好的产业链基础。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

□ 是 √ 否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
半导体器件	1,231,026,804.78	422,478,735.70	34.32%	25.11%	20.70%	-1.26%
半导体芯片	204,659,903.94	74,476,771.03	36.39%	28.80%	24.58%	-1.23%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入980,826.20元，调增资产处置收益980,826.20元。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司出资2,519,400.00元收购子公司上海派骐微电子有限公司全部股权。

报告期内，子公司杰利半导体公司与重庆平伟实业股份有限公司共同出资设立重庆杰伟公司，注册资本5,000万元，杰利半导体公司认缴其注册资本的90.00%，截至资产负债表日尚未出资。